

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2026-062

天津金海通半导体设备股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元，募集资金总额为人民币878,700,000.00元，根据有关规定扣除发行费用131,888,125.09元（不含税）后，募集资金净额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月24日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金60,317.76万元，募集资金账户余额为人民币13,109.65万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 2 月 24 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

项目	金额
一、募集资金总额	87,870.00
减：直接支付发行费用	13,188.81
二、募集资金净额	74,681.19
减：	
截至 2025 年 12 月 31 日已使用金额	53,804.08
2026 年 1-6 月使用金额	6,513.68
现金管理金额	3,400.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.17
加：	
募集资金利息收入	2,146.39
三、报告期期末募集资金余额	13,109.65

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023 年 2 月 24 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天津金海	上海浦东发展银行	7723007880190	12,833.02	使用中

通 半 导 体 设 备 股 份 有 限 公 司	股份有限公司天津 科技支行	0001822		
天 津 金 海 通 半 导 体 设 备 股 份 有 限 公 司	上海银行股份有限 公司天津华苑支行	03005262096	64.36	使用中
江 苏 金 海 通 半 导 体 设 备 有 限 公 司	中信银行股份有限 公司上海分行	8110201012301 598875	212.27	使用中
天 津 金 海 通 半 导 体 设 备 股 份 有 限 公 司	上海银行股份有限 公司天津华苑支行	03005261995	0	已注销
合计			13,109.65	

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截至2026年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币60,317.76万元，具体情况详见附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年2月26日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。

公司于2026年2月2日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，2026年2月3日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 2 月 24 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
32,000	投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品	2025 年 2 月 26 日	2026 年 2 月 25 日	2025 年 2 月 26 日
22,000	投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品	2026 年 2 月 3 日	2027 年 2 月 2 日	2026 年 2 月 3 日

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

受托人	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率	实际收益或损失
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	35,000,000.00	2025 年 12 月 11 日	2026 年 1 月 14 日	1.60%	52,164.38

受托人	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率	实际收益或损失
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	150,000,000.00	2026年1月4日	2026年1月30日	1.90%	205,833.33
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	150,000,000.00	2026年2月9日	2026年2月26日	1.55%	109,791.67
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	34,000,000.00	2026年2月12日	2026年4月15日	1.60%	92,405.48
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	150,000,000.00	2026年3月2日	2026年3月31日	2.00%	241,666.67
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	140,000,000.00	2026年4月7日	2026年4月30日	2.00%	178,888.89
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	34,000,000.00	2026年4月23日	2026年5月27日	1.50%	47,506.85
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	140,000,000.00	2026年5月8日	2026年5月15日	1.50%	40,833.33
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	140,000,000.00	2026年5月18日	2026年5月29日	1.50%	64,166.67
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	120,000,000.00	2026年5月31日	2026年6月30日	1.80%	174,000.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	34,000,000.00	2026年6月4日	2026年7月8日	1.50%	47,506.85

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金3,205.05万元继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资，保荐机构出具了核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用。

七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用。

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附表 1:

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2023 年 2 月 24 日										
本年度投入募集资金总额			6,513.68										
已累计投入募集资金总额			60,317.76										
变更用途的募集资金总额			3,205.05										
变更用途的募集资金总额比例			4.29%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项	研发项目	否	43,615.04	不适用	43,615.04	6,509.78	32,567.80	-11,047.24	74.67	2026 年 10 月	不适用	不适用	否

目													
年产 1,000 台 (套) 半导体测试分选机机械零配件及组件项目	生产建设	是	11,066.15	7,861.10	7,861.10	3.90	7,636.96	-224.14	97.15	已终止 (注 1)	不适用	不适用	是
	其他-暂未确定投向			3,205.05	3,205.05	0	0	-3,205.05	0	暂未确定投向	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	补流	不适用	20,000.00	不适用	20,000.00	0	20,113.00	113.00 (注 2)	100.57	—	—	—	—
合计			74,681.19	—	74,681.19	6,513.68	60,317.76	-14,363.43	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。												

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：公司终止募投项目“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金 3,205.05 万元继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）以及于 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

注 2：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

注 3：“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”已终止，但截至 2026 年 6 月 30 日止，实际投资金额与募集后承诺投资金额之间尚存 224.14 万元差额（系根据合同计算的暂估金额，最终以项目实际支付为准），上述差额因相关款项尚未完成支付所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2023 年 2 月 24 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	年产 1,000 台（套）半导体测试分选机	生产建设	江苏金海通半导体设备有限公司	江苏省南通市	7,861.10	7,861.10	3.90	7,636.96	97.15	已终止	不适用	不适用	不适用	2025 年 5 月 29 日	2025 年 6 月 16 日

暂未确定投向	械零配件及组件项目	其他-暂未确定投向	-	-	3,205.05	3,205.05	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	2025年5月29日	2025年6月16日
合计					11,066.15	11,066.15	3.90	7,636.96	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			变更原因：基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景，可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。公司借此机会，进一步强化了与零配件及组件委外加工供应商的议价能力，优化了供应链管理体系，从而提升了供应链的稳定性和成本效益。经公司审慎评估，采用“供应商外协生产机械零配件及组件”的生产方式较“公司自建机加工中心”更匹配公司当下发展需求且更具成本效应，同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。 决策程序及信息披露情况：公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，保荐机构对公司该募集资金投资项目终止事项无异议。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）以及于2025年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。												
未达到计划进度的情况和原因 （分具体募投项目）			不适用												

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
-----------------------------	------------